证券代码：301510　　证券简称：固高科技

固高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-011

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☑现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	中国银河证券股份有限公司　总监　吴少兰 景顺长城基金　研究院　王彬宇 深圳国金永恒私募证券投资基金管理有限公司　投资总监　郭梦茹 湖南常昇私募基金管理有限公司　副总　曹伟 仁毅私募基金管理（海南）合伙企业（有限合伙）　基金合伙人　潘恒亮 广州市蓝海私募证券投资基金管理有限公司　副总　张俊 深圳市卡尔曼投资有限公司　董事长　王文之 广东云杉常青证券投资基金管理有限公司　基金经理　李福磊 深圳市海利祥私募证券投资基金管理有限公司　副总　张俊皓 深圳市金田私募证券投资基金管理有限公司　基金合伙人　汪邯鄲 SECF 投资　中国区合伙人　崔乾林

时间	2026年11月10日
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李小虎先生

投资者关系活动主要内容介绍	1、半导体/泛半导体设备及机床电控的竞争格局如何？ 公司主要产品是控制器、驱动器等电控部件与运控系统。公司产品服务于半导体/泛半导体设备、数控机床、工业激光、3C自动化设备等机电设备主机。 在半导体/泛半导体设备领域，设备电控传统上主要供应商有ACS、Aerotech、ELMO、科尔摩根、倍福等；中高端机床领域主要数控系统供应还是由西门子、海德汉、Fanuc、三菱这样的国际同行主导。这两个设备领域是比较典型的加工精度在微米、亚微米、纳米精度的高端装备领域，包括公司在内的国内同行在部分机型与市场有部署突破，但整体上仍处于追随态势，这部分高端装备的电控市场空间还是较为可观的。 2、公司在半导体、光模块的增长速度，是否比我们预计的更快一些？ 从截至到三季度的数据来看，确实比年初预期要好。 年初时公司整体预期30%的增长。从三季度数据来看，整体营收有70%+。半导体/泛半导体这个领域收入相对去年同期翻倍还多，这里面光模块加工为代表的耦合、固晶、共晶贴片等设备领域的应用部署在今年的增长很快。 3、公司收入增长较快，但研发费用率有所下降如何理解？ 公司一贯重视研发，前面三五年研发投入占比基本保持在接近20%；公司人员结构中研发人员占比也持续保持在40%以上。现阶段研发占比下降，主要是今年营收增长较快后分母增大导致的一个数字呈现；研发投入的绝对金额仍会保持增长。 另外公司所处行业本身有着产品研发、商业周期较长的特征，当期的费用支出与投入获取的营收回报之间会有较长的滞后期，这个特征导致企业规划支出时不能简单地直接联动当期营收，需要导入更多的历史经验。目前看到的确实是营收增长与费用支出计划之间出现的一点表观背离。 4、伴随公司营收规模扩张，研发费用会持续保持高比例吗？

	可能会是一个折中的状态。一是公司作为工控企业，但重点拓展半导体、数控机床这样的微纳机电设备，确实还会有许多的技术、产品研发迭代，需要较高的研发费用支撑。另一方面，营收规模增长上去后，研发费用占比大概率还是会逐步下降。 所以最终可能是研发费用绝对值仍然会中长期保持增长，但在营收占比中逐步下降。 5、公司业务是核心部件与系统，会否出现客户通过自研来跳过这个环节的情况，公司以何种机制绑定头部客户？ 真实有效的商业合作一定是基于价值基础。在商业活动中，公司提供的价值如果高于客户自研的价值，或者说公司提供的价值高于客户自研成本，从而让客户自身商业有更大利润空间，那么这个合作大概率就是稳定双赢的。 公司基本策略就是在擅长的领域高效地创造价值。公司目前针对半导体/泛半导体设备、数控机床等高端装备领域微纳精度控制需求提供核心部件与系统，实际上就是这个基本思路的体现。 简单来说，就是如果公司的技术、产品与服务让客户能更顺利、更多地赚钱，那么合作就能很好地维持。 6、上游电子元件涨价对成本有影响吗？ 公司产品采用备料生产方式，公司通常依据下一年的生意规模做适当的备料。截至三季度，公司产品在成本上确实受益于去年为今年的备料。 由于今年业务增长较快，去年备下的物料在三季度差不多完结，所以四季度以及明年预计，电子器件涨价会对公司产品成本有所推升，具体的影响量我们也在等四季度的数据出来。 7、公司产品有考虑提价吗？ 等四季度，或者明年一、二季度营运数据出来公司再做决定。 公司各营运部门有讨论，目前的基本思路是先不做大的改动，继续紧跟市场变化边走边看。

	8、从公司前两三年数据来看，利润在五六千万，今年业绩与利润挺好，公司在战略上有什么考虑或者说变化吗？ 应该说，公司自成立以来战略定位就是解决高端装备的核心技术问题，这个定位至今未变。问题中提到的营收上的变化，应该说是这个战略定位的阶段性呈现。 在半导体设备、数控机床等高端装备领域，控制器、伺服驱动器或者系统等部件与系统产品的速度、精度、可靠性等功能性能指标达到国际同行的水平只是及格线，这并不意味着商业就能落地。这个领域真正的门槛实际上是国际领先同行数十年甚至是百年间一点点在业界构建起来的长期稳定高质量的信任度。这个生态门槛只能在较长时间内一点点地用实际部署案例来磨平。所以这个领域一直就有着进入周期长、入圈后商业生命周期也长的特点。 公司前面十多年间分别在LED芯片封装设备、消费电子雕铣加工中心等抓住机遇切入，逐步在圈里获得认可。所以这次光模块耦合、共晶、贴片等加工装备机会释放时，就有了比较好的承接。实际这是公司持续针对高端装备提供电控部件与系统解决方案这个战略的阶段性商业呈现。 9、光模块加工装备需求的持续性公司怎么看，能持续多久？ 这次伴随AI基建需求，光模块加工需求快速释放，从企业这里来看这个细分领域自25年四季度开始批量应用；截至26年三季度，这个领域保持了较好的增长。从一线业务人员的反馈来看，对27年的预期较为饱满；但更远的28年及以后业界在产品形态、技术路线上有多种讨论。 另外从公司角度来看，耦合机、固晶机等光模块加工设备应该是半导体/泛半导体装备的细分子领域，对这个持续性的讨论放在整个半导体/泛半导体装备框架下，会有更好的支撑。从企业这里来看，光模块相关装备应该是近2年的商业落地的业务；对增量期望更多会放在前道加工装备、量测设备以及先进封装设备上。当然这些预期需要在接下来逐个季度跟进，各位投资者请谨慎评估。

	10、公司考虑通过并购实现扩张吗？ 高端装备核心部件与系统涉及门类很多，公司不排除通过并购方式补全技术、产品、渠道与服务等环节，为客户提供更好更完整的服务。 但就目前而言，管理层尚未获知或形成有并购动作的计划与时间节点，管理层精力目前仍集中在内生业务的成长上。
附件清单（如有）	无